

电子

周跟踪 (20240617-20240623)

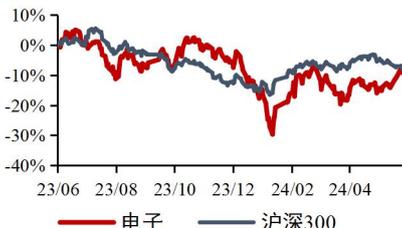
领先大市-A(维持)

周期上行需求回暖, 制造端出现涨价信号

2024年6月24日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源: 最闻

相关报告:

【山证电子】苹果发布首个生成式 AI 大模型, 博通 FY24Q2 业绩超预期-山西证券电子行业周跟踪 2024.6.17

【山证电子】先进封装大势所趋, 国产供应链机遇大于挑战-【山证电子】行业深度报告 2024.6.17

分析师:

高宇洋

执业登记编码: S0760523050002

邮箱: gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码: S0760522050001

邮箱: xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体:** 本周 (2024.06.17-06.21) 市场涨跌不一, 上证指数跌 1.14%, 深圳成指跌 2.03%, 创业板指数跌 1.98%, 科创 50 涨 0.55%, 申万电子指数涨 1.86%, Wind 半导体指数涨 2.48%, 费城半导体指数跌 1.07%, 台湾半导体指数涨 4.96%。细分板块中, 周涨跌幅前三为集成电路封测 (+4.98%)、模拟芯片设计 (4.87%)、消费电子 (+3.11%)。从个股看, 涨幅前五为: 华铭智能 (+104.20%)、金溢科技 (+46.85%)、锴威特 (+46.54%)、晶华微 (+32.91%)、东晶电子 (+31.75%); 跌幅前五为: *ST 超华 (-21.82%)、英力股份 (-17.06%)、航天智造 (-17.04%)、贝仕达克 (-15.52%)、海能实业 (-13.97%)。

➢ **行业新闻: SEMI: 全球半导体晶圆厂产能预计 2024 年增长 6%, 2025 年增长 7%。** SEMI 在最新季度《世界晶圆厂预测报告》中表示, 为了跟上芯片需求持续增长的步伐, 全球半导体制造产能预计将在 2024 年增长 6%, 并在 2025 年实现 7% 的增长, 达到每月晶圆产能 3370 万片/月的历史新高 (以 8 英寸当量计算)。5 纳米及以下节点产能预计在 2024 年将增长 13%, 主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能 (AI) 的驱动。**2028 年, AI 将推动服务器市场增长至 2,730 亿美元。** TechInsights 预测, 到 2028 年 AI 将推动服务器市场达到 2730 亿美元, 年复合增长率将达 18%, 专为 AI 应用设计的服务器将占市场份额的 59%, 年复合增长率为 49%。**台积电将针对 3/5nm 先进制程和先进封装涨价 20%。** 据台媒《工商时报》, 在产能供不应求的情况下, 台积电将针对 3/5nm 先进制程和先进封装执行价格调涨。其中, 3nm 代工价涨幅或在 5% 以上, 先进封装明年年度报价也约有 10%-20% 涨幅。目前, 台积电的 3nm 的全部产能已经被英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌全部包圆, 供不应求, 预期订单满至 2026 年。

➢ **重要公告:【星星科技】** 拟以现金收购广西立马电动车科技有限公司 100% 股权, 转让价格为 21,000 万元。**【芯联集成】** 拟通过发行股份及支付现金的方式向滨海芯兴、远致一号等 15 名交易对方购买其合计持有的芯联越州 72.33% 股权, 本次交易为收购控股子公司少数股权。

投资建议

➢ 受益 AI 持续拉动算力与端侧设备需求, 叠加 H2 消费电子新品出货补库, 晶圆厂稼动率回升, 部分制程恢复满载, 部分平台出现涨价信号, 制造端改善迹象逐步清晰。全球半导体产能扩充仍在持续, 大基金三期落地打开行业 capex 空间, 上游环节直接受益。建议关注设备、材料、零部件的国产替代, AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求, 及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
4. 风险提示.....	11

图表目录

图 1: 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2: 周涨跌幅集成电路封测、模拟芯片设计、消费电子表现领先.....	4
图 3: 月涨跌幅模拟芯片设计、集成电路封测、半导体设备表现领先 (30 日滚动)	5
图 4: 年初至今涨跌幅元件、半导体设备、消费电子表现领先.....	5
图 5: 多数板块当前 P/E 在历史平均值附近.....	5
图 6: 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7: 本周个股涨幅前五.....	6
图 8: 本周个股跌幅前五.....	6
图 9: 全球半导体月度销售额及增速.....	6

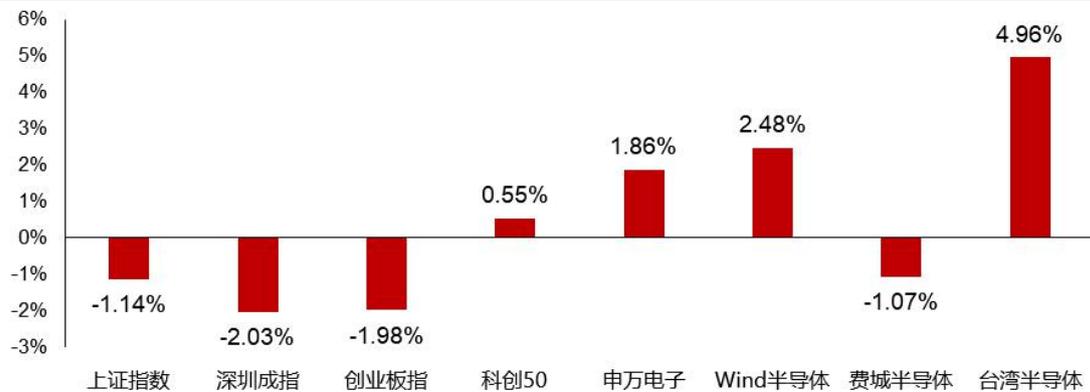
图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货平均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.06.17-06.21）市场涨跌不一，上证指数跌 1.14%，深圳成指跌 2.03%，创业板指数跌 1.98%，科创 50 涨 0.55%，申万电子指数涨 1.86%，Wind 半导体指数涨 2.48%，费城半导体指数跌 1.07%，台湾半导体指数涨 4.96%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

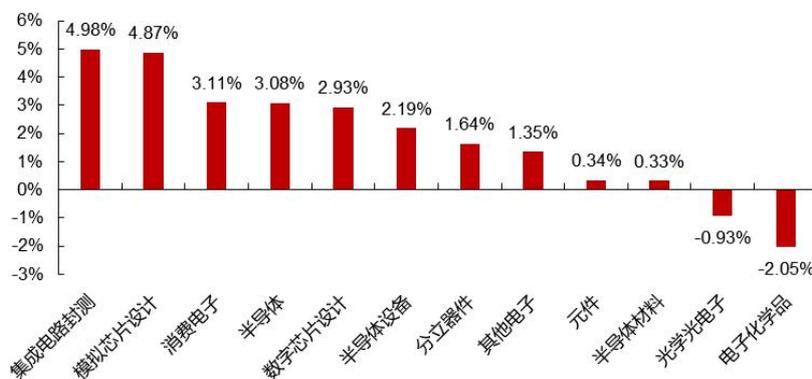


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

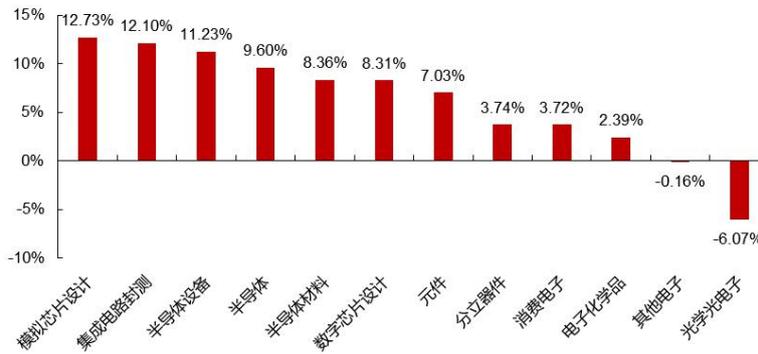
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅集成电路封测、模拟芯片设计、消费电子表现领先



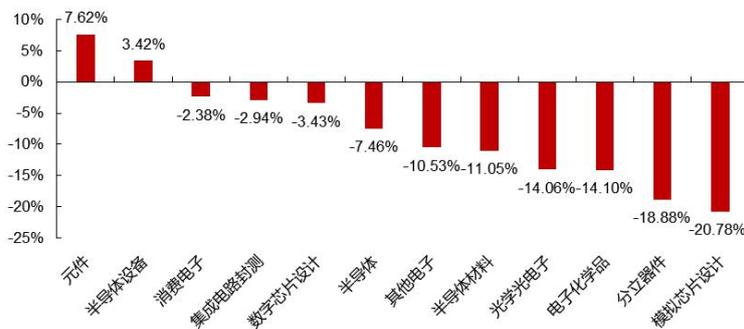
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅模拟芯片设计、集成电路封测、半导体设备表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

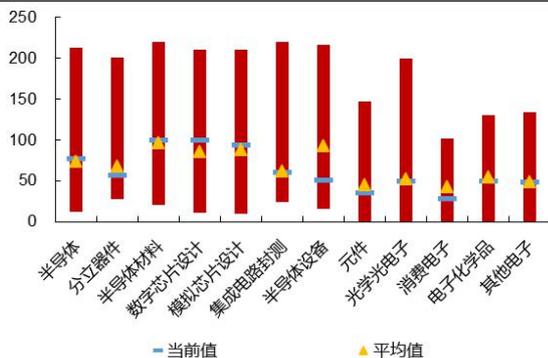
图 4：年初至今涨跌幅元件、半导体设备、消费电子表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

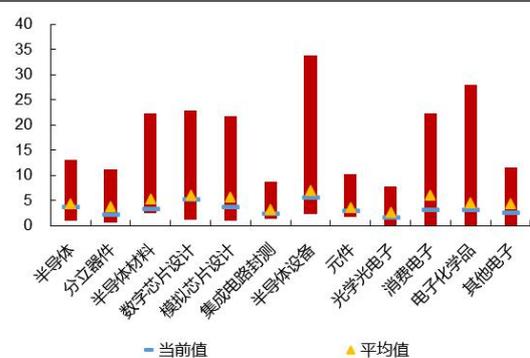
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 在历史平均值附近



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

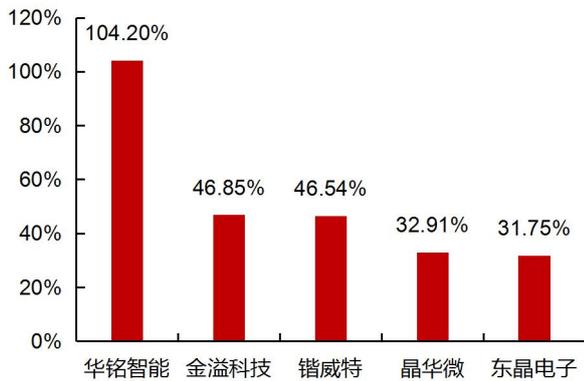


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

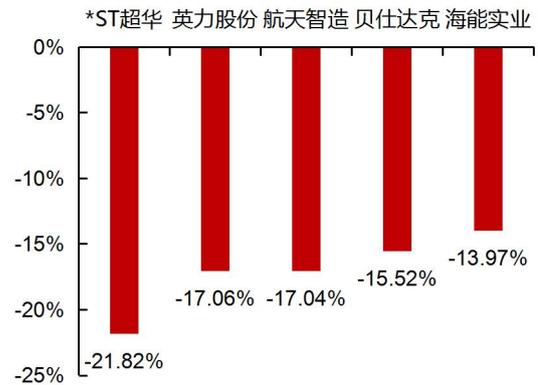
从个股情况看，华铭智能、金溢科技、锆威特、晶华微、东晶电子涨幅领先，涨幅分别为104.20%、46.85%、46.54%、32.91%、31.75%；*ST超华、英力股份、航天智造、贝仕达克、海能实业跌幅居前，跌幅分别为-21.82%、-17.06%、-17.04%、-15.52%、-13.97%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

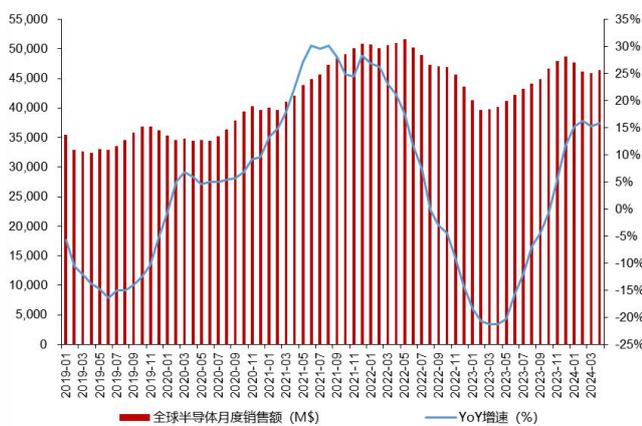
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

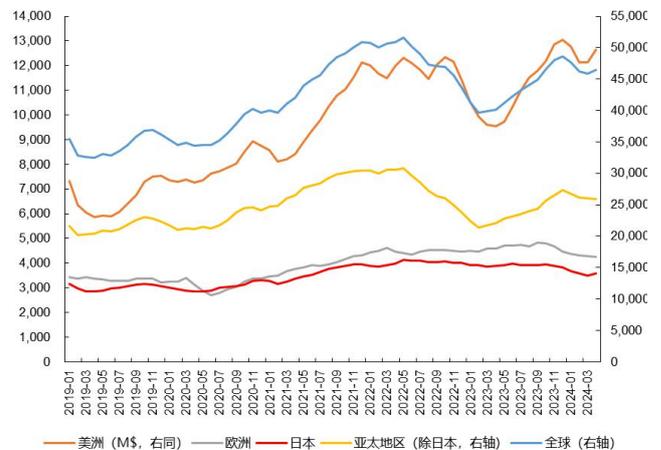
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



资料来源：WSTS，山西证券研究所

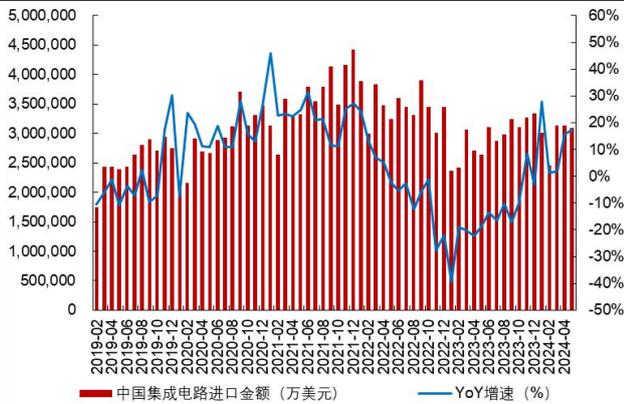
图 10：分地区半导体销售额



资料来源：WSTS，山西证券研究所

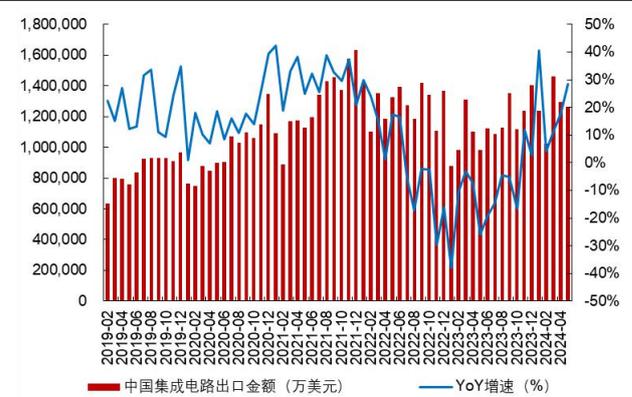


图 11: 中国集成电路行业进口情况



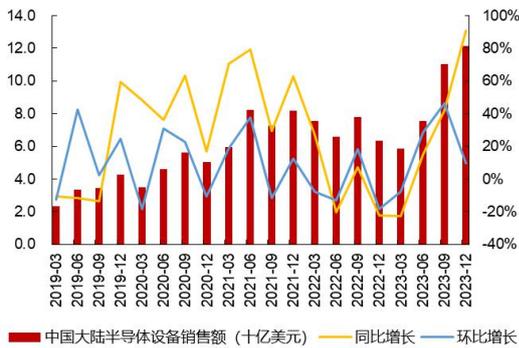
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 12: 中国集成电路行业出口情况



资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 13: 中国大陆半导体设备销售额



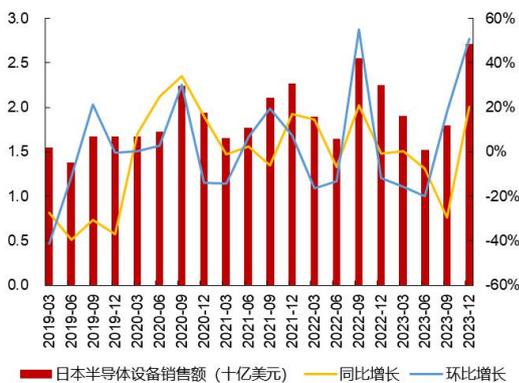
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 14: 北美半导体设备销售额



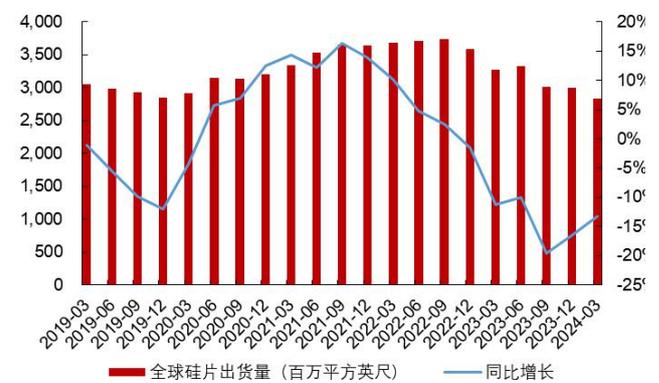
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 15: 日本半导体设备销售额



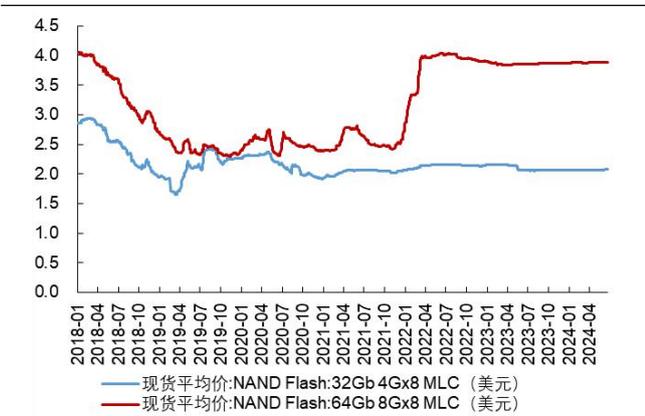
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 16: 全球硅片出货面积



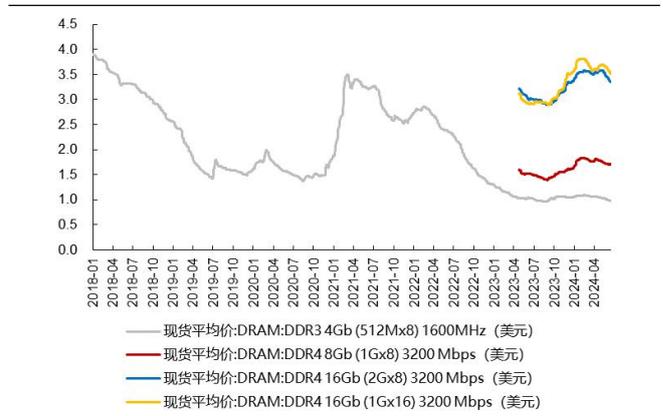
资料来源: SEMI, 山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



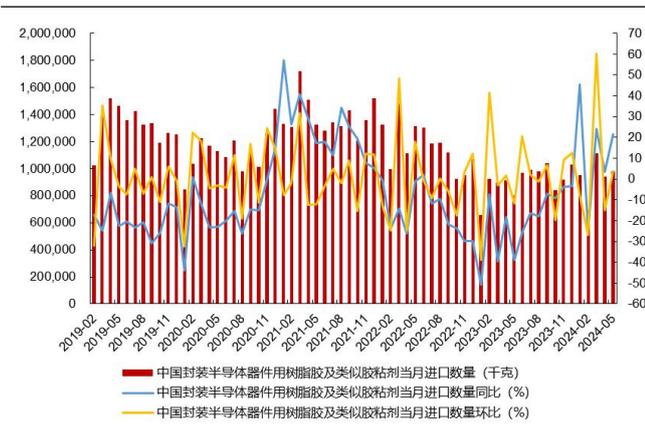
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



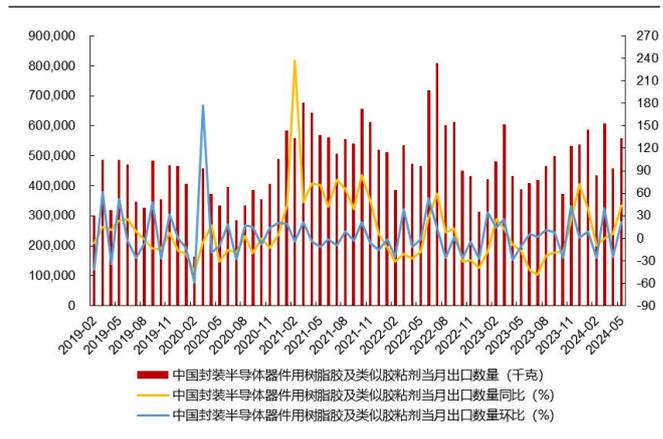
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



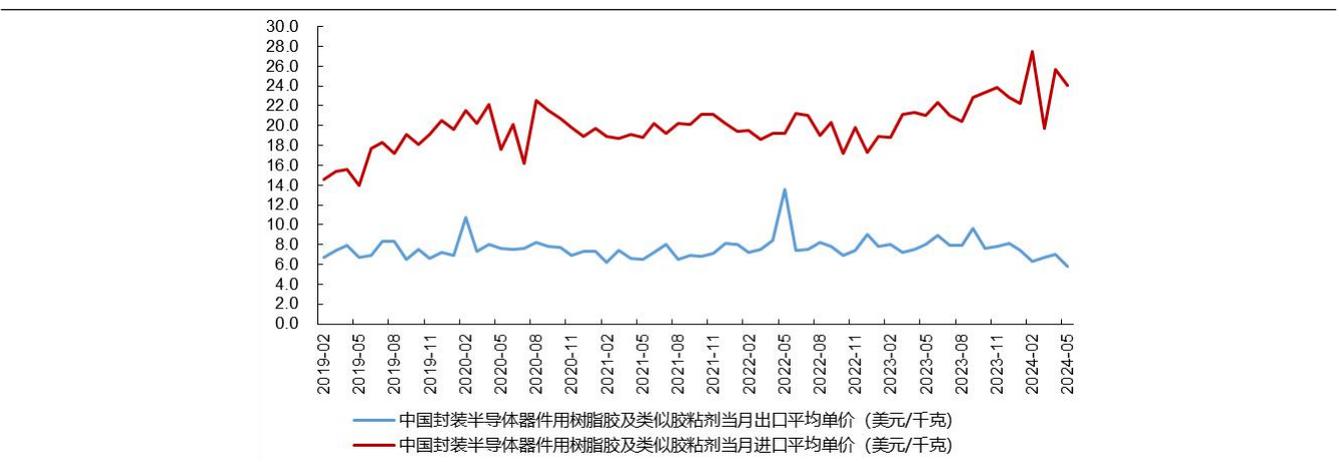
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



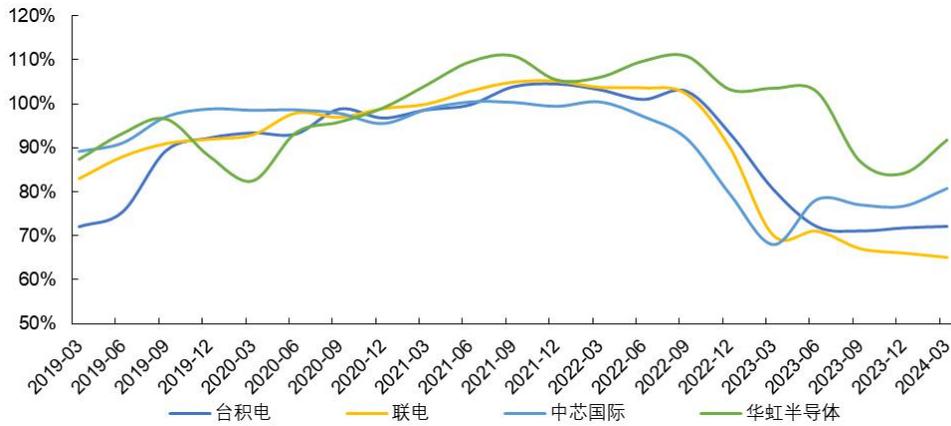
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



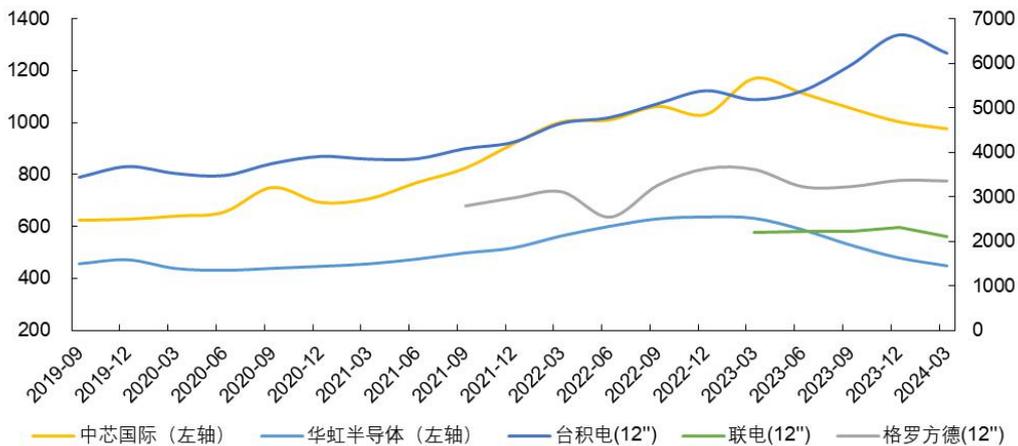
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22: 晶圆厂稼动率 (%)



资料来源: 各公司季报, 山西证券研究所

图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)



资料来源: 各公司季报, 山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1: 本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 6 月 17 日			金百泽、炬芯科技		
2024 年 6 月 18 日			峰昭科技、富创精密、恒玄科技、		

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
			鸿合科技、瑞联新材、新洁能		
2024年6月19日		汇创达	源杰科技		
2024年6月20日		爱克股份	宏微科技		
2024年6月21日		易天股份、富信科技	安集科技		
2024年6月22日		伟测科技、拓荆科技、深科达	天承科技、安凯微	星星科技	芯联集成

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年6月16日	vivo 印度公司被迫出售。 在印度政府的持续打压之下，vivo 等中国智能手机制造商正被迫出售其印度子公司的多数(至少 51%)股权,以便能够继续在印度运营。据 MoneyControl 消息人士透露，印度塔塔集团正就收购中国智能手机制造商印度子公司——vivo India 至少 51%的股权进行深入谈判。尽管谈判取得了重大进展，但因为估值存在差异，最终交易尚未达成。	芯智讯
2024年6月17日	台积电将针对 3/5nm 先进制程和先进封装涨价 20%。 据台媒《工商时报》报道，在产能供不应求的情况下，台积电将针对 3/5nm 先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，3nm 代工价涨幅或在 5%以上，先进封装明年年度报价也约有 10%-20%涨幅。目前，台积电的 3nm 的全部产能已经被英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌全部包圆，供不应求，预期订单满至 2026 年。	券商中国
2024年6月18日	SEMI 报告：全球半导体晶圆厂产能预计 2024 年增长 6%，2025 年增长 7%。 美国加州时间 2024 年 6 月 18 日，SEMI 在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast 中宣布，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年实现 7%的增长，达到每月晶圆产能 3370 万片 (wpm, wafers per month) 的历史新高 (以 8 英寸当量计算)。5 纳米及以下节点的产能预计在 2024 年将增长 13%，2nmGAA (Gate All Around) 芯片，在 2025 年将总的先进产能增长率提高 17%。	SEMI
2024年6月20日	台积电据称研发新的先进芯片封装技术。 台积电正在与设备和材料供应商合作开发这种新技术，可能需要数年时间才能商业化。据悉，这种新技术将使用矩形基板，而不是传统的圆形晶圆，这样就可以在每个晶圆上放置更多组芯片。这项新技术仍处于早期研究阶段，但标志着台积电在技术上的重大转变，该公司以前认为使用矩形基板太过于具有挑战性。为了让新技术得以应用，台积电和其供应商将不得不投入大量的时间和精力进行开发，并升级或更换大量生产工具和材料	财联社
2024年6月21日	工信部：强化汽车芯片标准供给。 工信部 21 日发布《2024 年汽车标准化工作要点》，其中提到聚焦战略新兴领域，加快关键急需标准研制，持续完善新能源汽车标准，加大智能网联汽车标准研制力度，强化汽车芯片标准供给。	中国新闻网
2024年6月21日	2028 年，AI 将推动服务器市场增长至 2730 亿美元。 TechInsights 预测，到 2028 年，AI 将推动服务器市场达到 2730 亿美元，年复合增长率将达 18%。近年来，服务器需求呈周	TechInsights



时间	内容	来源
	期性波动，受更新周期影响显著。人工智能在这一增长中起到关键作用。预计到 2028 年，专为 AI 应用设计的服务器将占市场份额的 59%，年复合增长率为 49%。这些服务器通常配备更多高性能处理器内核、内存、存储和网卡，以处理复杂的 AI 应用。	

资料来源：芯智讯，券商中国，SEMI，财联社，中国新闻网，TechInsights，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

